

Builder 注销

SPC

Microsoft Excel - 4A17900TA0-预审指示

编写指示

负片蚀刻

PN4A17900TA0版本

编写郭乐平审核郭乐平

PPQE文控

常规

参数

NO	项目	参数
1	成品最小SMT宽度 (mil)	9.84
2	成品最小BGA (mil)	/
5	局部最小补偿 (mil)	/
11	阻抗线宽/线距控制公差/	
12	最小焊环宽度 (mil)	4
13	BGA尺寸公差 (±)	+/-15%
14	SMT尺寸公差 (±)	+/-15%

型号

菲林图

供应商

有无条孔

工艺备注

型号备注

订单备注

文件(E) 编辑(E) 视图(V) 插入(I) 格式(O) 工具(T) 数据(D) 窗口(W) 帮助(H) Adobe PDF(B)

宋体 10 B I U

C10 删除如图线路层和阻焊层，贴片层这些线框，只保留字符层的。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	预审指示								
2	产品编号	4a17900ta0			预审日期	2013-7-24		预审人	欧阳垚
3	待确认光绘时一起确认问题	序号	待与客户确认问题(原因与内容)						预审建议
4		1							
5		2							
6		3							
7	工艺流程指示								
8	CAM指示	1	外层完成1oz						
9		2	所有焊盘按正公差控制。						
10		3	删除如图线路层和阻焊层，贴片层这些线框，只保留字符层的。						
11		4							
12		5							
13		6							
14		7							
15		1	表面清洁：超声波清洗，无杂质离子污染						